
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 我們的增長戰略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]所述範圍的中位數），我們估計我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除[編纂]佣金及有關[編纂]的其他估計開支）。

我們擬將預期從[編纂]收取[編纂]淨額按以下載列用途及金額使用：

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於提升我們的研發能力並推動產品創新。我們當前的存儲技術面臨若干技術瓶頸。在先進的AI應用場景中，我們遇到了顯著的性能限制：推理過程會引發並行數據讀取需求的激增，這對存儲傳輸效率和隨機訪問速度提出了更高要求，而現有主控芯片往往難以高效應對。功耗問題是AI端側設備面臨的重大挑戰。移動及電池供電產品必須始終支持AI功能運行，同時實現超低能耗，以維持最佳用戶體驗。此外，數據量的快速膨脹帶來不斷升級的存儲容量壓力，亟需適配更高層數、更高密度的NAND晶粒，以應對容量擴張需求。該等問題因封測能力的局限而進一步複雜化 — AI模型推理及高端AI端側設備需要更優的信號傳輸速度、更高的封裝信號密度以及更大的數據帶寬，然而當前技術常在散熱和結構穩定性方面存在不足，可能影響長期可靠性。我們計劃對自研主控芯片、高性能半導體存儲解決方案及晶圓級封測能力進行投資。此外，我們計劃在未來四年內聘用300多名具備多元化的學術與專業背景的研發人員，以支持我們研發能力的提升。隨著我們的研發項目在範圍及技術深度上不斷擴展，我們的技術必須持續迭代以跟上行業發展，同時我們希望引進更多高素質且經驗豐富的人才加入研發團隊，以增強我們的創新能力。在主控芯片研發方面，我們計劃聘請持有微電子、電子信息或相關學科碩士或以上學位，或具備至少五年集成電路設計或驗證經驗的候選人，以加強我們在基於NAND存儲解決方案的主控芯片設計能力，並將工作拓展至AI計算和邊緣計算等更高價值領域，這些領域需要能夠支持更多元化及可擴展存儲需求的升級版芯片架構。針對存儲解決方案，我們計劃聘請具備電子、計算機科學、通訊或相關工程領域背景，或擁有相關行業經驗的人員，以支持UFS、eMMC及PCIe產品的開發與升級、在成熟產品中使用新型存儲介質，以及針對智能可穿戴設備、智能汽車及其他應用、PC OEM產品、自有品牌產品及企業級產品的產品工作。在先進封測方面，我們計劃聘請具備電子封裝、微納電子學、微電子製造、電子信息工程或相關領域背景，或擁有相關行業經驗的人員，以幫助我

未來計劃及[編纂]用途

們開發以更高密度、更高速度及更高可靠性連接計算芯片與存儲芯片的封測工藝。我們計劃根據項目進度、業務需求以及合適候選人的情況，分階段聘請這些人員，並預期這些招聘將有助於我們按計劃開展該等研發項目，並支持未來的產品開發。具體如下：

- (1) **自研主控芯片。**基於已成功量產的SP1800主控芯片，我們致力於進一步優化芯片架構以降低核心處理單元的能耗損失，並戰略性將技術標準從eMMC升級至UFS。這些採用UFS卓越傳輸速率的自研主控芯片，能夠滿足AI設備對實時數據處理的需求，使我們能夠提供客製化、差異化的解決方案，縮短交付週期並便於解決方案的維護。通過將升級後的主控芯片與先進固件算法相結合，並確保與大容量NAND晶圓的兼容性，我們將建立針對AI應用場景的優化解決方案。
- (2) **存儲解決方案設計。**我們的目標是投資於半導體存儲器解決方案(如UFS、eMMC、MCP、企業級SSD及PCIe SSD)的升級和創新。我們計劃將自研主控芯片與專屬固件算法、先進封測技術深度融合。這種方法使我們能夠精細調整性能、功耗和穩定性。這些解決方案專為滿足具有廣闊市場前景的AI應用場景的技術需求而設計，包括智能穿戴設備、智能移動終端、AIPC及服務器等領域。此外，針對AI數據中心對高帶寬、高效率存儲器的迫切需求，我們正重點開發RDIMM、LPCAMM及MRDIMM等先進內存模組。這涉及強化我們在軟硬件協同、高速信號設計、仿真、DRAM故障精準診斷及全鏈路測試方面的能力，以確保滿足高可靠性。
- (3) **先進封測能力。**我們擬通過專注於異質集成技術來加強我們的先進封測能力，尤其是晶圓級封裝。我們計劃為客戶提供緊湊型、低延遲及大容量的半導體存儲解決方案，滿足超薄AI應用的嚴格技術要求，使我們從業界同行中脫穎而出。我們還計劃實施基於人工智能的檢測與智能控制系統，使我們能夠實時監控生產流程並優化關鍵參數。此外，我們計劃招募先進封裝技術的業內頂尖專家，打造核心技術團隊，購買專業生產設備，以進一步提升我們的封裝及測試效率。

未來計劃及[編纂]用途

下表載列[編纂]在未來四年的具體分配計劃，以提升我們的研發能力並推動產品創新。

	2026年	2027年	2028年	2029年	總計
	人民幣千元				
自研主控芯片	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
設備及材料採購	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
研發人員薪酬	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
IP及EDA授權	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
後端設計及測試服務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
存儲解決方案設計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
設備及材料採購	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
研發人員薪酬	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
實驗室建設費用	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
後端設計及測試服務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
先進封測能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
設備及材料採購	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
研發人員薪酬	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
實驗室建設費用	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
後端設計及測試服務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

儘管我們預期該等投資將因研發開支及資本開支增加而在短期內影響我們的成本結構及現金流量，我們擬審慎管理該等影響。我們致力維持嚴格的成本控制，並可能通過仔細監控[編纂]用途，動態調整我們的研發活動的節奏及範圍。我們的策略側重於確保我們的研發工作指向具商業可行性、能夠產生足夠收入以收回前期投資的產品，從而減輕對我們的流動資金及財務狀況的負面影響。關於利潤率，雖然初始投資龐大，但我們的目標是開發具有高利潤率的高附加值產品，我們相信這將在長期內維持並可能提升我們的整體盈利能力。我們亦知悉研發固有的風險，包括可能無法實現技術突破，或新產品可能無法獲得市場接納或無法取得商業成功的風險。為應對該等風險，我們對產品開發及風險管理採取審慎方針，確保我們的創新工作符合市場需求及技術趨勢。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於我們的銷售及營銷活動、國際業務運營及全球客戶服務。我們的目標是利用本地製造實力及與行業夥伴的戰略合作，觸達全球客戶。此外，我們計劃在未來四年內合共招聘136名銷售及營銷人員，全部位於中國，以支持擴張策略。具體而言：
 - (1) **銷售網絡擴張及國際品牌戰略。**我們計劃拓展銷售網絡並加強渠道合作，以更好地服務國內客戶及海外市場(包括美洲、歐盟、亞太地區及中東)的客戶。我們擬在中國主要經濟發達城市及地區(包括北京、上海、廣東、湖北、浙江、江蘇及四川)擴大銷售佈局，該等地區的消費電子、汽車、工業及AI應用對存儲解決方案的需求日益增長。為進一步滲透國內市場，我們計劃在中國招募更多具備相關背景與專業知識的內部銷售及營銷人員，同時將引入分銷商以豐富我們的銷售渠道，隨著業務規模持續增長，我們現有的銷售人員可能無法有效支持我們在該等地區的計劃客戶覆蓋、項目及渠道管理。該等新聘人員將主要負責客戶開發、關鍵客戶覆蓋、產品推廣、渠道協調及客戶跟進。同時，我們將加強在全球的品牌建設。該等銷售及品牌推廣舉措將助力樹立高端的國際品牌形象。為加強國際品牌建設及市場影響力，我們計劃結合深入的市場分析能力與渠道多元化舉措，以助力成功進軍新的國際市場。對於海外市場，我們計劃通過具備服務海外客戶經驗的中國本土銷售及營銷人員，以及能夠提供本地客戶渠道及市場反饋的海外分銷商及渠道合作夥伴，來擴大我們的海外銷售覆蓋範圍。同時，我們擬通過參與行業展會、開展針對性的媒體與電子商務推廣，以及對數字基建與視覺形象(如網站開發與高品質產品設計)進行重大投入，以推動市場拓展。
 - (2) **本地化運營與技術支持服務。**我們計劃通過招募具備全球運營經驗的國內人才，建立並壯大經驗豐富的運營和客戶服務團隊，從而能夠為Meta及Google等全球客戶提供更及時及定制化的服務。該等團隊將立足中國，充分利用與我們中國本土製造及研發團隊的強大協同，並與提供本地快速響應能力的海外代理商及分銷商緊密合作。我們具備全球視野和技術支持的運營團隊將提升客戶體驗。
 - (3) **穩健的全球製造與交付體系。**我們旨在持續升級我們東莞及惠州的生產基地，並建立一個立足中國、具韌性的製造及交付系統，以服務全球客戶。該生產基地主要計劃生產eMMC、UFS、SSD及LPDDR5產品。我們不擬透過該升級來提升整體產能。相反，部分[編纂]淨額將用於透過以下兩項具體措施提升東莞及惠州生產基地的營運效

未來計劃及[編纂]用途

率及優化交付時間表：(i)購置先進設備(如半導體空中懸掛搬運系統及倉庫自動導引車(AGV))以提高自動化水平；及(ii)建造及維護額外的倉庫及配套物流設施。該等措施使我們能夠在不擴大製造產量的情況下，縮短交付週期、降低處理成本，並為包括主要科技公司在內的國際客戶提供更可靠、更能快速響應的服務。這不僅能優化向全球客戶的交付效率，還能增強我們整體的服務能力，確保穩定供應我們的解決方案。

下表載列[編纂]在未來四年的具體分配計劃，以支持我們的全球擴張策略。

	2026年	2027年	2028年	2029年	總計
	人民幣千元				
銷售網絡擴張及國際品牌戰略	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
本地化運營與技術支持服務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
穩健的全球製造與交付體系	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

該等舉措將在短期內增加銷售及分銷開支，並可能擴大現金流出與流入之間的差距。然而，我們將密切追蹤該等成本，縮減或暫停未達預期的推廣活動以保障流動性。雖然較高的開支預計將在初始投資階段壓縮經營利潤率，但我們相信由此帶來的品牌知名度及市場滲透率提升將推動收入增長，從而支持利潤率隨時間逐步恢復。我們認識到營銷投資帶有某些風險，例如客戶轉化速度慢於預期、競爭加劇或不利的宏觀經濟狀況，而我們通過分階段推出、實時績效分析及定期策略檢討來管理該等風險，以確保資金能迅速重新配置至最高效的渠道。

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於潛在戰略投資、合作以及併購機會。儘管我們尚未就該等項目的數量制定具體計劃，但我們擬在投資方式上採取靈活策略，可包括股權收購、成立合資企業或資產收購。特別是，我們打算專注於在主控芯片設計、固件算法、芯片IP、SLC及MLC NAND介質分析以及先進封測能力方面具有互補技術的目標。例如，我們計劃投資於具備企業級存儲主控芯片設計及固件算法能力的公司。這將增強我們企業級SSD產品的競爭力，使我們對供應鏈擁有更大的控制權，並使我們能夠為AI數據中心提供更具競爭力的企業級存儲解決方案。此外，我們計劃投資於具備SLC及MLC NAND介質分析與設計能力的公司。這將建立我們在存儲介質分析與設計方面的專業知識，這對於車規級存儲解決方案及智能可穿戴設備等嵌入式及邊緣計算應用至關重要。例如，將MLC NAND介質設計與我們現有的eMMC及UFS主控芯片設計相結合，可提升汽車應用的可靠性及性能，並增強嵌入式應用及AI端側設備的電源效率。我們亦在尋找擁有成熟AI應用客戶群的公司，以加速我們在半導體存儲解決方案終端市場的市場滲透，如AI新興端側、數據中心、智能計算及互聯解決方案以及智能汽車。我們的目標公司包括該等已服務或與AI相關應用場景的客戶有持續業務關係的公司。該等公司包括：為AI數據中心開發企業級存儲解決方案的公司、為自動駕駛、機器人及AI端側應用提供工業及車規級存儲解決方案的公司，以及為AI PC及其他智能消費電子設備提供高端存儲解決方案的公司。我

未來計劃及[編纂]用途

們認為，該等措施將使我們能夠收購或合作擁有互補技術及客戶資源的企業。這將增強我們的全棧技術能力，豐富我們的產品組合，並擴大我們在AI數據中心、智能汽車、機器人、工業AI端側、AI PC及其他關鍵垂直領域的客戶覆蓋，從而加速我們向下游市場的滲透。我們僅尋求位於中國的目標，且並未對潛在目標的業務規模、營運歷史或具體收入與利潤門檻設有硬性限制。根據弗若斯特沙利文的資料，市場上有超過100個符合我們選擇標準的潛在目標。該等舉措將通過使我們能夠快速獲取領先的互補性技術以增強全棧技術能力，並協助我們擴大客戶覆蓋範圍及豐富產品矩陣，從而產生協同效應，加速市場滲透。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體的潛在投資或收購目標。

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂][編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例增加或減少擬定用於上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用於上述用途，或倘我們未能按計劃實施未來發展計劃的任何部分，我們只會將該等資金存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見《證券及期貨條例》或其他司法權區適用法律法規）的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露要求。

倘因政府政策變動導致我們所發展的任何項目不可行或因發生不可抗力事件等原因，以致我們的發展計劃任何部分未能按計劃進行，我們將審慎檢討情況，而可能重新分配[編纂][編纂]淨額。